

新技術

【SiC・サファイア】研削・研磨をはじめ シリコンウエハ 研削・研磨・洗浄の

一貫加工でスピードと信頼性に自信!!

六甲プレミアムプロセス

進化を続ける当社自慢の+αの新工程

新技術

BG前	面取り加工	BG後
	※面取り加工無し	※ナフエッジが形成される
		※研磨厚みに合わせた面取り形状を形成出来ます。

薄ウエハ面取り加工 有・無比較

お客様の問題点に即かい合い、機械メーカー殿のご協力を得て模索したものが、『六甲プレミアムプロセス』



滑浄度(ボタン付ウエハ裏面)

SiC・サファイアウエハ 研削・研磨・洗浄



新技術

既存のシリコン加工機で SiC・サファイアウエハ研削・研磨を実現。現状の専用機での加工に比べ高速・低ソリ・高直粗度・大口径対応が可能となり、一貫加工にて対応が可能です。

パワーデバイス



研削→研磨→RCA洗浄の
一貫加工が我々の強み

パワーデバイスは他のデバイスとは異なり、高い電圧が流れるため高耐圧のシリコンを使用しており、また、それに伴って電流の数値も高くなるため、耐熱性も必要になってきます。高耐圧化については、シリコンにエピ成長をさせ高い電圧に対応できる完全結晶とさせ、耐熱性についてはウエハを薄くすることにより、放熱性を向上させます。我々、六甲電子は後者のウエハを薄くすることに対応し、ウエハの裏面研削を行っております。また、お客様個々の製品特性に影響を与えないようゲッターリング層を形成すべく研削するような砥石・レシビのノウハウを有し、時間を掛け確認し、信頼性の高い製品を提供しております。

半導体センサー / MEMS 研削・研磨



接合面の平坦度を
保つため、長年の研削・
研磨技術が冴える

各種センサーに用いられるウエハは、お客様により表面に回路を形成し、その後、弊社により裏面の薄化研削を行います。回路を形成されたウエハは高付加価値な商品であり、取扱いには細心の注意を払い、表面にダメージを及ぼさないようテープの選定を行ったうえで、保護し研削を行います。また、パワーデバイス同様、お客様個々の製品特性に影響を与えないようゲッターリング層を形成すべく研削するような砥石・レシビのノウハウを有し、時間を掛け確認し、信頼性の高い製品を提供しております。

東京ビッグサイト

展示ホール・小間番号 : 出展者名
Hall4 4107 : 六甲電子(株)

パワー・センサー向けウエハ薄化加工「六甲プレミアムプロセス」と、
6インチ SiC 基板研削技術

モニター再生加工

モニターウエハの再生加工とは、お客様工場の各プロセスで使用済みになったテスト(モニター・ダミー)ウエハを受領後、当社にて再生加工・検査を施すことにより新品テストウエハと同等品質に再生し、複数回の使用を可能とするリサイクル事業です。



コンタミ・パーティクル・
平坦度が決め手

研削・研磨・ RCA 洗浄 一貫加工

当社では精密度を有するシリコンウエハの表面・裏面の研削・研磨を一貫工程で高精度に仕上げ、迅速な納品が可能です。また、多種・多様な MEMS などの特殊研削・研磨の加工についても量産 / 試作問わず 1 枚よりお受けいたします。お客様の多様なご要望に応じて研削・研磨のトータルで加工できることが我々の強みです。



一貫加工が
六甲電子の強み

半導体製造の一翼を担う企業として挑み続けています

六甲電子株式会社
www.rokkodenshi.com

まずはお見積りからお問合せください

〒663-8105 兵庫県西宮市中島町 8 番 5 号

TEL 0798-65-4508

✉ info@rokkodenshi.com

